

第1章 原子结构与键合

1. 原子中一个电子的空间位置和能量可用四个量子数来描述：

(1) 主量子数 n (2) 角量子数 l_i (3) 磁量子数 m_i

(4) 自旋量子数 s_i

(1) 能量量子数：决定原子能级以吸收或释放平均距离、运动、电子所处的能量层。

仅限于 $n=1, 2, 3, 4 \dots$ 分别对应 K, L, M, N 电子层。

(2) 角量子数：在同-量子层内所处的角量子数，与电子运动的角速度有关。取值 0, 1, 2, ..., $n-1$ 。
如 $n=2$, 则有 $l_1=0$ 和 $l_1=1$ 两个电子层。

$$l_i = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

能级 $\rightarrow p, d, f, g, \dots$

(3) 磁量子数：每个轨道角量子数的能量数或轨道数。

每个 l_i 下的磁量子数总数为 $2l_i + 1$ 。

$|l_i=2\text{时, 磁量子数为 } 2 \times 2 + 1 = 5, \text{ 为 } -2, -1, 0, 1, 2$

(4) 反映电子不同的自旋方向：规定为 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ ，反映顺时针和逆时针两种自旋方向，用“↑”和“↓”表示。

2. 核外电子分布的三个原则

(1) 能量最低原理：电子的分布总尽可能使体系的能量最低。

(2) 泡利不相容原理：在同一个原子里不可能有运动状态完全相同的两个电子。

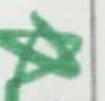
不能有上述四个量子数相同的电子。泡利原理：最多容纳 $2s^2$ 电子。

(3) 洪德规则：在同-亚层中的各个能级中，电子的分布尽可能分占不同的能级，而且自旋方向相同。

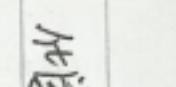
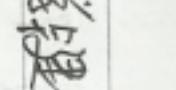
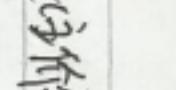
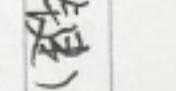
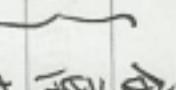
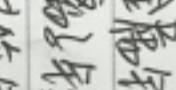
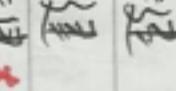
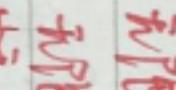
当排列分布为全充满、半充满或全空时，是比较稳定的，所以能量最低。

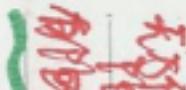
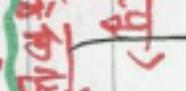
1. 实际上铁原子的电结构为

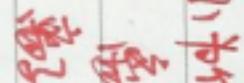
$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$$

 表填满的3d能级使铁产生磁性行为。

3. 原子间的结合

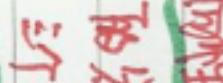
 金属键  共价键  离子键  配位键  强极性共价键  弱极性共价键  极性共价键  非极性共价键

 物理键 (次价键)：范德瓦尔斯力  活泼力: $R \propto r^{-1}$ 成反比
 色散力: $\propto r^{-6}$ 成反比

 小为什么弱的诱导和偶极性?
 离子键要按正负离子作相同排列，并使带电离之间吸引力比例最大，而同号离于间的斥力为最小，故离子键无方向性和饱和性。

② 为什么共价键有方向性和饱和性?

 除 s-s 的电荷云与球形对称外，其他如 p,p; d,d 等的电荷云都有一定的方向性。成键时，为使电荷云达到最大重叠，共价键就有方向性和饱和性。

 分布严格服从键的指向性。当一个键和另一个键同时以后，就不单和第一个键同时，成键时，为使电荷云达到最大重叠，共价键就有方向性和饱和性。

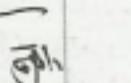
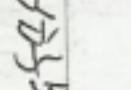
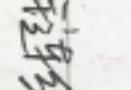
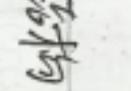
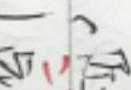
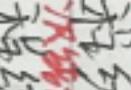
③ 为什么高的频率波有气态、P.液态和固态?

 因为一般高分子材料的相对分子质量很大，其总的范德瓦尔斯力甚至超过化学键的键能，故在去除所有的范德瓦尔斯力作用前化学键是早已断裂了，所以高的往往没有气态，只有液态和固态。

4. 高分子结构

一、次结构

构型: 电子的类型和排列，链结构成分

 高分子链结构  低分子链结构  二元共聚物  三元共聚物  五元共聚物  七元共聚物

 三元共聚物: 单体的大小与形态，链隙隙隙性及分子链的构象。

 聚合态结构  高聚物: 组态结构(不同部分之间或部分与添加剂之间)

1) 二次结构: 单个高分子的构象 ① 伸直链 ② 无规线团 ③ 折链 ④ 螺旋链

2) 相邻链单元的结合组成，高分子可分为① 疏松高分子 ② 紧密高分子

3) 亲水高分子 ④ 梯形和双螺旋高分子。

4) 分子链的几何形态: 线型、交化、交联和三维网状分子结构。

① 结构单元而链接方式:

1.1 加聚、3,4加聚、1,4加聚 (双烯类单体)

1.2 共聚物: 交替共聚物、无规共聚物、嵌段共聚物、接枝共聚物 (要改变构型必须通过链传递和重组)

5) 高分子链的构型: (要改变构型必须通过链传递和重组)

① 放射异构: $\text{CH}_2-\text{CHR}-$ 中按 R 的排列方式不同，分为

1. 同向异构、间向异构和无规立体构。
② 双向异构: 双烯类单体加成: 顺式构型及反式构型。

5. 影响高分子柔韧性的主要因素

① 环型结构的影响；② 极性基团的影响；③ 交联的影响。

① C-C, C-N, Si-O 带性比 C-C 大；无极性结构时柔韧性较好；双烯类主链含双键，柔韧性较好，但有极性双键的高分子柔韧性差。
② 极性基团越大，柔韧性越差；极性基团越少，间隔越远，柔韧性越好。
同一溶液上两个不同浓度时，柔韧性降低；侧基越大柔韧性越小。

第二章 固体结构

价物AB中离B最近的点C(31) LC 可以近似用下式表示。

$$LC = \left[1 - e^{-0.25(x_A - x_B)^2} \right] \times 100\%$$

x_A, x_B 分别为 A, B 元素的电负性值。
电负性差值越大，离子键所占比例越多。

晶胞选取的原则

- (1) 选取的平行六面体应反映出点阵的最高对称性；(2) 平行六面体内的棱和角相等的数目应最多；(3) 当平行六面体的棱边夹角在直角时，直角数目应最多；(4) 在满足上述条件的情况下，晶胞应具有最小的体积。

2. 七种晶系的十四种布拉维点阵：

- (1) 三斜：简单三斜 (2) 单斜：简单单斜、底心单斜 (3) 正交：简单正交、高心正交、体心正交、面心正交 (4) 三方：简单三方 (5) 菱方：简单菱方 (6) 四方：简单四方、体心四方 (7) 立方：简单立方、体心立方、面心立方

3. 晶向指数 $[uvw]$, 晶向族 $\langle uvw \rangle$

晶面指数 (hkl) , 晶面族 $\{hkl\}$

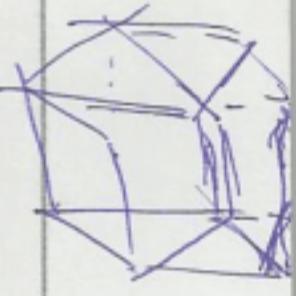
(1) 近晶族，晶向族 $\langle 100 \rangle$ 表示与某一个棱平行方向； $\langle 110 \rangle$ 表示与某一个面平行方向； $\langle 111 \rangle$ 表示体对角线方向。指教看特征，顺着走向。

(2) 晶面族 $\{hkl\}$ 中的晶面数 (晶面平行算一个)

- ① hkl 三个数均不相等，且都不可被 2 整除，则有 $3! \times 4 = 24$ 组，如 $\{123\}$
- ② hkl 有两个数能被 2 整除，且都不可被 4 整除，则有 $\frac{3!}{2!} \times 4 = 12$ 组，如 $\{112\}$
- ③ hkl 三个数均相等，则有 $\frac{3!}{3!} \times 4 = 4$ 组，如 $\{111\}$
- ④ hkl 中有一个为 0，应除以 2，则有 $\frac{3!}{2!} \times 4 = 12$ 组，如 $\{120\}$
- 若有两个为 0，应除以 2^2 ，则有 $\frac{3!}{2! \times 2!} \times 4 = 3$ 组，如 $\{100\}$

在立方晶系中，具有相同指数的晶向和晶面必定是互相垂直的。

密排六方



$$\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$$

佛心方 $h+k+l=6$

h, k, l 不全为奇数

4. 六方晶系中面网指标与三轴坐标转化关系

- (1) 对晶面指标而言, $(hki_l) \rightarrow (hkil)$ 需去掉 i 即可。
 $(hkl) \rightarrow (hkil)$ 需加上 $i = -(h+k)$.

(2) 对晶向指标而言, $[uvw] \rightarrow [uvtw]$ 的转化关系为

$$U = u - t \quad V = v - t \quad W = w$$

$$U = \frac{1}{3}(2U - V), \quad V = \frac{1}{3}(2V - U), \quad t = -(U + V), \quad W = W$$

5. 所有平行或相较于某一直线的晶面构成一个晶带。

此直线称为晶带轴。

晶带轴 $[uvw]$ 与该晶带的晶面 (hkl) 之间存在以下关系:

$$hu + kv + lw = 0$$

① 若已知两个平行晶面 $(h_1k_1l_1)$ 和 $(h_2k_2l_2)$, 则其晶带轴的晶向指数

$[uvw]$ 可由下式求得

$$u:v:w = \begin{vmatrix} k_1 & l_1 \\ k_2 & l_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} l_1 & h_1 \\ l_2 & h_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} h_1 & k_1 \\ h_2 & k_2 \end{vmatrix}$$

② 若已知两个不平行晶面 $(h_1k_1l_1)$ 和 $(h_2k_2l_2)$, 则由晶向决定的晶面指数

$$(h_1k_1l_1) \text{ 为 } h:k:l = \begin{vmatrix} V_1 & W_1 \\ V_2 & W_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} U_1 & W_1 \\ U_2 & W_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} U_1 & V_1 \\ U_2 & V_2 \end{vmatrix}$$

③ 若三个晶面 $[u_1v_1w_1], [u_2v_2w_2]$ 和 $[u_3v_3w_3]$ 满足

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = 0, \text{ 则三个晶面在同一个晶面上。}$$

④ 若三个晶面满足 $(h_1k_1l_1), (h_2k_2l_2)$ 和 $(h_3k_3l_3)$

$$\begin{vmatrix} h_1 & k_1 & l_1 \\ h_2 & k_2 & l_2 \\ h_3 & k_3 & l_3 \end{vmatrix} = 0, \text{ 则这三个晶面同属一个晶带。}$$

6. 晶面间距:

$$\text{① 正交晶系 } d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(h^2 + k^2 + l^2)}}$$

适用范围:
简单晶胞

$$\text{② 立方晶系 } (a=b=c), \quad d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3}(h^2 + hk + k^2) + (l^2)}}$$

修正: 对复杂晶胞

① 体心立方, 当 $h+k+l$ = 奇数时; ② 面心立方: 当 h, k, l 不全为偶数或不全为偶数时; ③ 密堆积; $h+k=3n$ ($n=1, 2, \dots$), (h 为奇数时, 也有附加面)。以上情况下实际的晶面间距须修正。

7. 对称性元素

回转对称轴 (n) 1, 2, 3, 4, 6

反映
对称中心 (i)

四维对称轴 $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$

转动 $\%$

$$\begin{cases} \text{滑移面} & a \ b \ c \ n \ d \\ \text{螺旋面} & a \ b \ c \ n \ d \\ \text{螺旋转轴} & 2_1; \ 3_1, 3_2; 4_1, 4_2, 4_3; 6_1, 6_2, 6_3, 6_4, 6_5; \\ & b_1, b_2, b_3; \end{cases}$$

\hookrightarrow 平移 $a/2, b/2, c/2$ 时, 写 a, b, c 。

若对角线平移 $c/2$, 写 i 。

沿面对角线平移 $1/4$, 写 d 。

$$\bar{1}: i \quad \bar{2}: m \quad \bar{3}: 3+i \quad \bar{4}: 3+m$$

free Al: Al, Cu, Ni, P-Ti, B-Co, Au, Ag, Rh, Pt
 bcc A₂: Cr, V, Mo, α -Fe, β -Ti, Nb, W, β -Zr, G, Ta No.
 hcp A₃: Be, Mg, Zn, Cd, α -Ti, α -Co, α -Zr, Ru, Re, Os

8. 经度沿赤道线读数；纬度沿基圆读数。
 使用多尔夫网时必须使两点位于多尔夫网经线或赤道上，才能正确角度
 量晶轴(或晶向)之间的夹角。

位于同一经线上的晶面指数)，属于同一晶带。应用多尔夫网在赤道上
 向右量出 90° 可求得其晶带轴。

9. 某晶面 (hkl) 能产生衍射的重要条件是该晶面相对入射束
 的方位和晶面间距 d_{hkl} 应满足布拉格方程： $\lambda = 2d \sin\theta$
 晶体点阵中的任一晶面 (hkl) 在倒易点阵中，可用一个相
 应的倒易阵点 $[hkl]^*$ 表示，从倒易点阵的原点到该倒易点
 阵的矢量称为倒易矢量 \vec{G}_{hkl} 。倒易矢量 \vec{G}_{hkl} 的方向即为晶面 (hkl)
 的法线方向，则模等于晶面间距 d_{hkl} 的角数。
 $\vec{G}_{hkl} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$

$$\vec{G}_{hkl} = \frac{1}{d_{hkl}}$$

$$\vec{a}^* = \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})} = \frac{1}{V_0} (\vec{b} \times \vec{c})$$

11. 合金组元之间的相互作用及其所形成合金相的性质主要是由它
 们的各自的电负性、原子尺寸、电子密度三个因素控制的。
 根据它们的电负性、原子尺寸、电子密度三者综合影响，
 相互作用力的强弱可分为固溶体、置换固溶体、间隙固溶体。
 不同的固溶体具有不同的物理性质。

影响溶解程度的因素：
 ① 固溶体结构相同 → 无限固溶体。
 ② 原子尺寸：原子半径差 $\Delta r < 15\%$ 时有利形成溶解度较大的固溶体。
 ③ 化学亲和力（相似性）：相似相间的元素才能具有大的溶解度。
 ④ 价数：溶解价数越高，影响实质上是“阳离子所决定的”。

致密度是指单位体积中晶体占总体积的百分数。
 金属晶体有孔隙，影响金属性能（合金相结构和扩散相等）。

金属晶体有孔隙，影响金属性能（合金相结构和扩散相等）。

同素异构转变对金属能够通过热处理来改善它的性能
具有重要意义。

同种固溶体都是有限固溶体，而且溶解度很小。
 γ_{AB} 的值越小，扩散阻力越大。

γ_{AB} 的值越小，扩散阻力越大。

$\gamma_{AB} = \frac{A(1-\alpha) + B\alpha}{100}$

A, B 分别为溶剂和溶质原子数分数。
一价金属溶剂，晶体结构为 fcc，扩散系数为 1.36；
bcc 时为 1.48； hcp 时为 1.75。

此外，固溶度还与温度有关，大多数情况下，温度升高，固溶度升高；
而对二价金属中间相的复杂合金，情况则相反。

12. 固溶体中溶质原子排列方式主要取决于同类原子间的结合能
 E_{AA} , E_{BB} 和不同原子间的结合能 E_{AB} 的相对大小。

如果 $E_{AA} \approx E_{BB} \approx E_{AB}$, 则溶质原子倾向于呈无序分布 $\leftrightarrow \alpha_i > 0$
如果 $(E_{AA} + E_{BB})/2 < E_{AB}$, 则溶质原子呈偏聚状态， $\rightarrow \alpha_i > 0$ $\leftarrow \alpha_i < 0$
如果 $(E_{AA} + E_{BB})/2 > E_{AB}$, 则溶质原子呈部分有序或完全有序排列。

以杂质 B 原子为中心，各同心球面上分布 A, B 组元原子。
若在 i 层球面上共有 C_i 个原子，其中 A 原子的平均数目为 n_i 个，若

已知该合金成分中 A 的摩尔分数为 m_A ，则此层上 A 原子数目应为 $M_A C_i$ ，短档序参数 α_i 定义为 $\alpha_i = 1 - \frac{n_i}{M_A C_i}$

$$\alpha_i = 0 \text{ 时} \quad n_i = M_A C_i, \text{ 固溶体为完全无序分布;}$$

$$\alpha_i < 0 \text{ 时} \quad n_i > M_A C_i, \text{ 固溶体处于短程有序。}$$

$$\alpha_i > 0 \text{ 时} \quad n_i < M_A C_i, \text{ 固溶体处于偏聚状态。}$$

a. 非金属与金属 M.
 $r_e / r_m < 0.59$ 形成间隙相 \rightarrow 单一固溶体
 间隙非金属氧化物和氮化物均为间隙相。
 且沿扩散金属相化物均为间隙化合物。
 比如固间隙相可分为 MX 、 M_2X 、 M_3X 和 M_4X 。
 间隙相中原子间结合强度大于键和金属键，具有高熔点和高硬度。

b. $r_e / r_m > 0.59$ 形成间隙化合物。

间隙化合物分为间结合键为共价键和金属键，熔点和硬度均较高（但不如间隙相），是钢中的主要强化相。

$$\textcircled{2} \quad \frac{L}{\alpha} = \frac{r_1}{r_2} \text{ 间隙相, hcp; } \frac{\alpha}{\alpha} = \frac{r_2}{r_3} \text{ 间隙相, fcc; } \frac{r_e}{\alpha} = \frac{r_3}{r_4}, \text{ 间隙相, bcc;}$$

组织：间隙相 > 间隙化合物

T₁P₁相。

C. 扩扑塞维相是由于两种大小不同的金属原子所构成的一类间隙相。
特点：①由CN为12, 14, 15, 16的四面体堆垛而成（每面均为三角形）；②呈层状结构，空间利用率很高，只有四面体的紧密堆垛，原子密排层系由三角形、正方形或六角形组合起来的网格结构。

扩扑塞维相的种类：I. 拉布斯相；II. 相；III. 相；IV. 相；V. R相；VI. P相。

I. 典型公式为AB₂, 形成条件①CN_AR_B: 1.05~1.68
②电子浓度：一定的结构类型对有着一定的电子浓度。

拉布斯相是镍合金中最重要的强化相。（但贵金属降低强度，硅增加且相通常布于过渡族金属元素组成的合金中，其分子式为AB₃或AB₃y，其化学成分在一定范围内变化，以化合物为基础固溶体，且相具有四方结构，C/a≈0.52每个晶胞30个原子，且相常遇下产生脆性，它的存在通常对合金性能有害。）

④ 有序化弱塞维相：半径之比而相与吸引大于同类型间隙化合物（长程有序度S）。

$$S = \frac{P - X_0}{1 - X_0}$$

完全有序 → 完全无序

	C/N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NaCl	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(NaCl) 正方	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(NaCl) 三方	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(NaCl) 三方	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(NaCl) 四方	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(NaCl) 六方	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(NaCl) 八面	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(NaCl) 十二面	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(NaCl) 十八面	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

	C/N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TiO ₂ (金红石)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(榍石) β-石榴石	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
α-Al ₂ O ₃	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(解砾石) CaTiO ₃	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(方解石) CaCO ₃	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
(滑石) MgAl ₂ O ₄	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Al ₂ O ₃	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

① 金属间化合物，特殊性质，磁磁性，绝缘材料，耐蚀性。
形状记忆效应，超弹性和消振性，热电发散性，优良的吸能性。

18. 硅酸盐分类：孔隙状、组群状、链状、层状和骨架状。

① 孔隙状 $[SiO_4]^{4-}$ 四面体以孤立状态存在。

例：镁橄榄石、铬英石。

② 组群状 $[Si_2O_7]^{6-} [Si_3O_9]^{6-} [Si_4O_{12}]^{8-} [Si_6O_{18}]^{12-}$

例：绿柱石、堇青石。

③ 链状硅酸盐 $a. [SiO_3]_n^{2n-} b. [Si_4O_11]_n^{6n-}$

例：a. 陶器材料，顽辉石，透辉石，锂辉石，钠长石

b. 鹦鹉石、斜方角闪石、不碱石、紫苏石、石榴英石等。

单链状结构中由于 Si-O 键键能比 M-O 键强，因此硅酸盐

酸盐矿物很脆而易被弱结合的羟基断裂成纤维。

④ 层状： $[Si_4O_{10}]^{4-}$ 双层结构、三层结构。

例：高岭土、滑石、叶蜡石、蒙脱石。

层状硅酸盐中，层内 Si-O 键键能比层与层之间分

离键键能强得多，因此结构易从层间剥离，形成片状解理。

⑤ 骨架状 SiO_4

例：石英、长石、霞石、沸石。

19. 硅酸盐晶体中为什么说要比金属型矿物多变型晶体的少？

答：由于共价晶体中相邻原子通过共价键形成稳定的四面体结构，因此，共价晶体的共同特点是遵守键价服从 8-N 法则。M-O 键的价数板，这就是说结构中每个原子里有 8-N 个相邻的原子。这一点就使得其价键结构具有饱和性。另外，共价晶体中各键的方向都有确定的位置，即其价键具有明显的方向性，这也导致共价晶体中离子的配位数要比金属型晶体的小。

20. 聚合物的形态主要有单晶、液晶、玻璃、树枝状晶、乳晶、纤维状晶和非晶等。

(1) 高分子单晶：浓度在 0.01% 以下的极稀溶液中缓慢结晶。

(2) 高分子球晶：最高分子多晶体的一种球形形式；

从浓溶液或熔体冷却结晶时获得。

球晶光学特征：偏光显微镜下可看到黑十字消光圆环。

球晶生长：多层片晶 → 圆球状形式 → 球状晶体。

(3) 高分子树胶状晶：温度较低或浓度溶液浓度较大，或相对分质量过大

→ 分子扩散成为结晶生长的控制因素。

球晶生长：高分子溶液边搅拌边结晶。

搅拌越快，结晶颗粒越大，结晶中伸直链晶体比例越大，晶

体熔点也越高；高浓度、抗溶剂、耐腐蚀。

(4) 高分子带晶：高温高压下结晶。

伸直链结构是高分子中热力学上最稳定的聚集体结构。

21. 为什么聚合物不能形成立方晶系？

答：聚化合物晶体中，沿大分子链的方向和垂直于大分子链方向的尺寸是不同的，使得聚化合物不能形成立方晶系。

22. 非晶态物质 / 玻璃 $\left\{ \begin{array}{l} \text{非晶态金属} \\ \text{合金} \end{array} \right.$

区别在于 有无玻璃转变点。

第3章 晶体缺陷

1. 晶体缺陷分类

点缺陷 (零维缺陷): 位点间隙原子、杂质或溶质原子
 线缺陷 (-维缺陷): 位错
 面缺陷 (二维缺陷): 壳界、相界、相界面和堆垛层错。

2. 点缺陷:

① **滑移基级缺陷:** 正常晶格结点上的原子移到晶体表面或内部的正常结点位置，而使晶体内部留下空位。
 ② **替位基级缺陷:** 正常晶格结点上把原子挤入到晶格间隙位置，而在晶体中形成数目相等的空位和间隙原子。

③ **离位缺陷:** 由隙>空位。形成能 E_V : 间隙原子浓度。平衡浓度: $\frac{N}{V}$
 在晶格中出现 Frankel 点缺陷时，升华率会增加。

④ **杂质缺陷:** 某些由于受激扰而逸出，脱离原核束缚变成载流子进入价带的空位，在它原来位置上留下空位(正U)，这种并发出的缺陷称色心 V_{lh} 。
 另进入别正带)空位上所激发缺陷称色心 F_{ch} 。

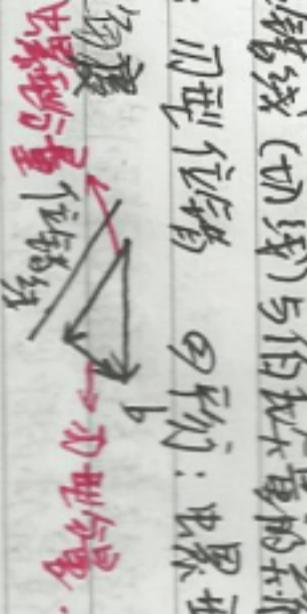
$$\text{密度平衡} \quad C = \frac{N}{V} = A e^{\mu} \left(-\frac{E_V}{kT} \right) = e^{\mu} \exp \left(-\frac{E_V}{kT} \right)$$

离位缺陷使得金属的电阻增加，体积膨胀，密度减小，提高了晶体的导电性改善了，过饱和点缺陷，如淬火空位，辐射缺陷，还可以提高金属的屈服强度。

3. ① 位错：① 正型位错“+”，刃型位错“T”，② 刃型位错线不一定是直线，但与滑移方向和滑移量有关；③ 刃型位错滑移面只须有一个（纯位错线，即滑移矢量）；④ 滑移面上的上应力随变形而变化，下应力受到拉应力“+”。

4. 螺型位错：①无额外半周平面；②分为右旋和左旋；③螺型位错线与滑移矢量平行，一定是有线；④位错线的移动方向与滑移方向互相垂直；⑤纯螺型位错滑移面不唯一，通常在原底排面上进行；⑥在垂直于位错线的平面上，看不到除了滑移和嵌入位错。

5. 混合位错：判别位错线（切线）与伯氏矢量的关系

- ①垂直：刃型位错 ②平行：螺型位错
③成一定角度 

8. 螺型位错可能会发生交滑移和双交滑移。
位错除可以在滑移面上滑移外，还可以在垂直于滑移面方向上运动，即发生攀移。

螺型位错没有多余的半周面，因此不会发生攀移运动。

而型位错的攀移本质上就是构成刃型位错的多余半周面而扩大或缩小。

因此，它可通过物质迁移来实现。一般定位运动引起攀移，即降低了攀移能的攀移需要消耗能量，称之为“非活性运动”，位错攀移需要热激活，较之滑移所带的能量更大。晶体中过饱和点缺陷间有攀移运动机制。

可以高温淬火、冷变形加工和高能辐照等。

高温淬火、冷变形加工
高能辐照...

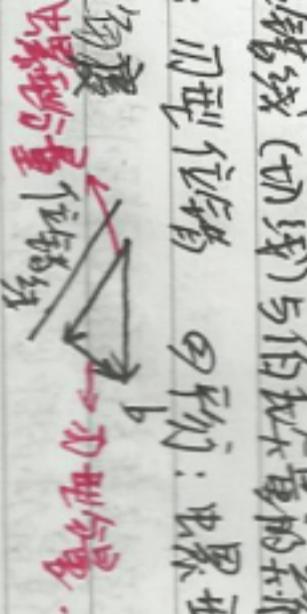
9. 刃型位错 / 剪切部分：刃型
螺型位错 / 扭转部分：螺型
攀移过程与剪切的形貌能和滑移速度有关。

- ①两个伯氏垂直的刃型位错交割 → 剪切（刃型位错）
②两个伯氏平行的刃型位错交割 → 扭折（螺型位错）

- ③两个伯氏垂直刃型位错交割 → 刃型产生台阶，螺型产生扭折

- ④两个伯氏垂直螺型位错交割 → 皆产生台阶（阻碍位错的移动）
台阶与原位错线在同一滑移面上，可随主位错线一起运动，时不产生阻力，而且台阶在剪切力作用下易于消失。

- 但当台阶与原位错线不在同一滑移面上，故除非台阶产生攀移，否则螺型就不能跟随主位错线一道运动，成为位错主体的障碍物，通常称此为台阶硬化。

- 位错的运动方式：滑移和攀移。
- 螺型位错：①无额外半周平面；②分为右旋和左旋；③螺型位错线与滑移矢量平行，一定是有线；④位错线的移动方向与滑移方向互相垂直；⑤纯螺型位错滑移面不唯一，通常在原底排面上进行；⑥在垂直于位错线的平面上，看不到除了滑移和嵌入位错。
- 混合位错：判别位错线（切线）与伯氏矢量的关系
- ①垂直：刃型位错 ②平行：螺型位错
③成一定角度 
- b. 伯氏矢量响应：①指出试面方向为位错线正方向（刃型位错“—”）
右手法则：以右手拇指、食指和中指构成直角坐标系。以食指指向位错线方向，中指指向伯氏矢量方向，在余半周子面的立向。
- 右手法则：若 $b_1 \rightarrow b_2, b_3$ 与 b_1 正向平行，则为右螺旋位错；
 $b_1 \rightarrow b_2, b_3$ 反向平行，则为左螺旋位错。
- 中性位错：②螺型位错中的伯氏矢量与位错线平行。
- 中性位错：若 $b_1 \rightarrow b_2, b_3$ 与 b_1 正向平行，则为右螺旋位错；
 $b_1 \rightarrow b_2, b_3$ 反向平行，则为左螺旋位错。
7. 同一晶体内，位错密度越大，表明该位错导致底阵畸变越严重，它们所能承受较高的位错通常称为两个能量较低的位错：
 $b_1 \rightarrow b_2, b_3$ ，并满足 $|b_1|^2 > |b_2|^2 + |b_3|^2$ ，以降低系统的自由能下降。
- 晶体质地的塑性变形是通过位错运动实现的。晶体力学性能如强度、韧性和断裂率均与位错的运动有关。

11. 位错应力假设：①晶体是完全弹性体，服从胡克定律；②把晶体看成是各向同性的；③近似认为晶体内部由简单形状组成，晶体中没有空隙。模型不适用于位错中心，对位错中心区以外的区域适用。

12. 螺旋位错应力场特点：（只有一个切应力）

1) 仅有切应力分量，正应力分量为零，即螺旋位错不会引起晶体的膨胀和收缩。

2) 螺旋位错的应力场是轴对称的；即与位错等距离的各处，其切应力值相等，并随着与位错距离的增大，应力值减小。

13. 正型位错应力场特点：

1) 同时存在正应力分量与切应力分量，而各应力分量的大小与 G 和 b 成正比，与成反比，即随着位错距离的增大，应力的绝对值减小。

2) 各应力分量都是 x, y 的函数，而不无关。即表明在平行于位错线直线上，任一点的应力也相同。

3) 正型位错的应力场对称于多余的半原子面 ($y-z$ 面)，即对称于 y 轴。

4) $y=0$ 时 $\sigma_{xy} = \sigma_{yy} = 0$, 说明在滑移面上没有正应力，只有切应力，而且切应力 T_{xy} 达到极大值。

5) $y>0$ 时， $\sigma_{xx}<0$; 而 $y<0$ 时 $\sigma_{xx}>0$ ，说明正型位错的位错滑移面上侧为压应力，滑移面下侧为张应力。

6) 在应力场任意处， $|\sigma_{xx}| > |\sigma_{yy}|$

7) $x=z$ 时， σ_{yy}, T_{xy} 为 0，说明在直角坐标系的两条对角线上，只有 σ_{xx} ，而且在 x 对角线的两侧， T_{xy} (σ_{yy}) 及 σ_{yy} 的符号相反。

14. 位错的能量分为两部分：①位错中心附近的弹性能量 [约占总能量的 $\frac{1}{10}$] ②位错运动场能的弹性效能。

$$(1) 单位长度螺型位错的应变能 E_e^e = \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln \frac{R}{r_0}$$

$$(2) 混合位错的应变能 E_e^m = \frac{Gb^2}{4\pi K} \ln \frac{R}{r_0}$$

其中 $K = \frac{1}{1 - \nu^2}$ $K \approx 1.20 \sim 1.75$ 为位错与位错线夹角。
综上，可将单位长度位错总应变能简化为

$$\bar{E} = \alpha G b^2$$

其中， α 为与材料因素有关的系数，其值约为 $0.5 \sim 1$ 。

15. 位错应变能的两个结论：

1) 位错能量包括两部分： E_e 和 E_c ，位错中心区能量较小，常忽略；而位错的弹性应变能 E_e^e 或 $\alpha / m R$ ，随 r 缓慢增加，所以具有长程应力。
2) 位错应变能与 b^2 成正比。因此从能量观点看，晶体中具有最小 b 的位错应该是最稳定的，而 b 大的位错可能分解为小的位错，以降低系统能量。由此也可理解解为滑移方向总是沿着原子的实排方向的。

3) $\bar{E}_e^e / E_e^e = 1 - \nu$ ，常见金属材料的 ν 约为 $\frac{1}{3}$ ，故螺型位错的弹性应变能约为刃型位错的 $\frac{2}{3}$ 。

4) 位错的能量是以位错弹性应变能量级的，故其还与位错形状有关。由于两点间直线最近，故直线位错总能量小于弯曲位错的，即更稳定。因此，位错有尽量变直和缩短其长度的趋势。

5) 位错在晶体内部不能分离，但有限，忽略。因此，位错的能量在晶体外示能的不稳定状态，可以使位错是热力学上不稳定的晶界缺陷。

16. 位错的线张力 T 可近似表达为 $T = kGb^2$, k 约为 $0.5 \sim 1.0$.
 一条两端固定的位错在切应力作用下将呈弯曲状态。

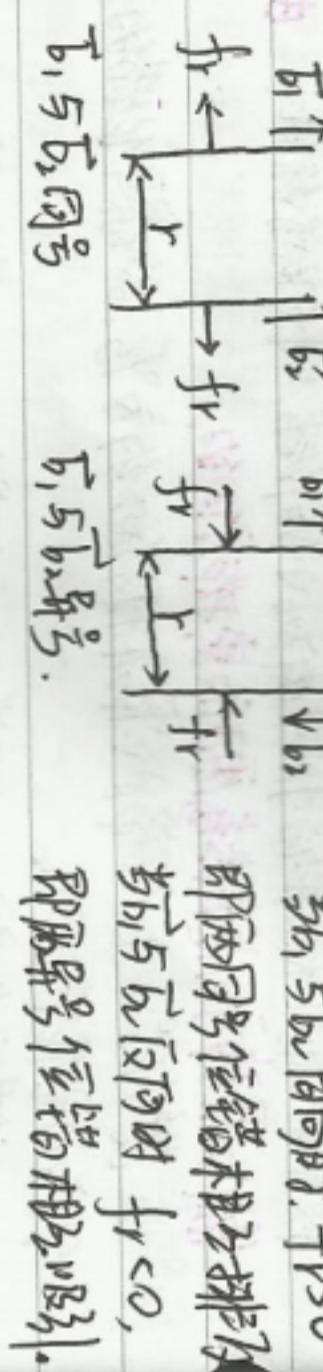
17. 作用在位错上的力:

(1) 滑移力 $F_d = Gb$ 是作用在单位长度位错上的力, 其方向是与位错线相垂直并指向滑移侧面的未滑移部分。 F_d 方向可以与 \vec{F}_d 方向不同。由于一根位错具有唯一的形状, 故只要作用在晶体上的切应力是均匀的, 那么各段位错所受的力的大小完全相同。

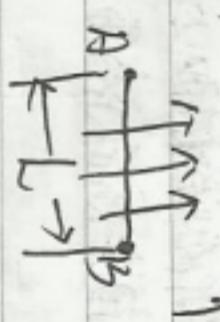
(2) 撞移力 $F_y = -\sigma b$, 作用在单位长度位错上的撞移力 F_y 的方向和位错线撞移方向一致, 也垂直于位错线。它是作用在多余半隙面上的正应力, 它的方向与 \vec{F}_d 平行。而另外 σ 为拉应力时 F_y 向下, 为压应力时 F_y 向上。

18. 两平行螺型位错的交互作用: $f_r = T_{xx} \cdot b = \frac{Gb}{L} \cdot b$

两个螺型位错的作用力, 其方向沿径向 r 垂直于所作用的位错线, 位错间距成反比, 其方向沿径向 r 垂直于所作用的位错线,



23. 使能统一理论不能适用的临界切应力 $T_c = \frac{Gb}{L}$



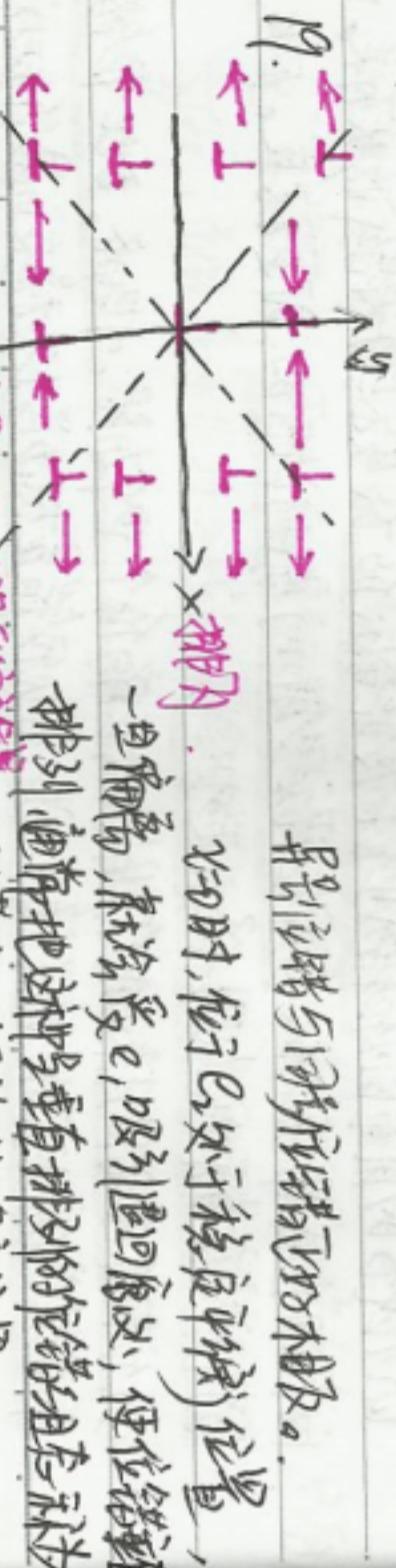
$$\text{简单立方 } a < 100 > a \quad 3$$

$$\begin{aligned} \text{面心立方 } &\frac{a}{2}(110) \quad \frac{\sqrt{2}a}{2} \quad b \\ \text{体心立方 } &\frac{a}{2}(111) \quad \frac{\sqrt{3}a}{2} \quad 4 \end{aligned}$$

24. 实际晶体中位错的种类:
 单位位错: 最稳定的位错
 全位错: 滑移后晶体原样排列不变
 不全位错: 滑移后原样排列被破坏变化
 部分位错

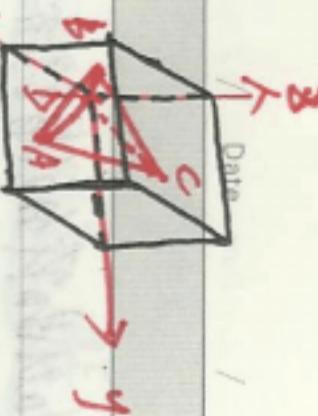
至于撞移力 F_y , 无论 σ 同号, 当位错 e 在位错 c 的滑移面上时, 撞移力 F_y 与 \vec{F}_y 方向相反; 当 e 在 c 滑移面下面时, F_y 为负值, 指向上。因此, 两位错沿 c 轴方向是互相排斥的。

简单立方	面心立方	体心立方	密排六方
$a < 100 >$	$\frac{a}{2}(110)$	$\frac{\sqrt{2}a}{2}$	$\frac{\sqrt{3}a}{2}$



同号位错: 相互吸引
 异号位错: 相互排斥

29. 沃普森四面体 (面心立方晶体)



25. 体心立方晶体的密排面 $\{110\}$ 和 $\{110\}$ 的堆垛顺序只能是 ABABAB... 故这两组密排面上不可能有堆垛层错。但 $\{110\}$ 和堆垛顺序是周期性的，可产生堆垛层错。

形成层错时并不产生点阵畸变，但破坏了晶体的完整性正常的周期性使晶发生反常的衍射效应故使晶体的能量有所增加称为“堆垛层错能”晶体中出现层错的几率与层错能有关 层错能越高则层错越少。

26. 层错与完整晶体的边界就是剪切位错。根据伯氏矢量线来判断，纯保型或混合型位错。即使是最纯类型的剪切位错也不能攀移，这是因为它有强烈的层错相关联，若进行攀移，则必离开此层错而故不可能进行。

27. 与抽出型层错联系的不全位错称为负兰克不全位错；与插入型层错联系的不全位错称为正兰克不全位错。

它们的伯氏矢量为 $\frac{1}{3}\langle 111 \rangle$ ，且都垂直于 $\{110\}$ 但方向相反。

而兰克位错属纯刃型位错。这种位错不能在滑移面上进行滑移运动，否则将使其离开所布的层错面，但能通过点阵的运动沿层错面进行攀移，使层错面扩大或缩小。

层错面进行攀移，使层错面扩大或缩小。
层错面不全位错 \rightarrow 不滑动位错或固定位错。

28. 位错应力场：

$$\sum b_i = \Sigma b_a$$

(1) 何解此：应后滑移层的伯氏矢量之和应该等于反应前滑移层的伯氏矢量。

(2) 能量条件：反应后各位错的总能量应小于反应前各位错的总能量。

$$\sum |b_i|^2 > \sum |b_a|$$

31. 体心立方晶体可能滑移面有 $\{110\}$, $\{112\}$ 和 $\{123\}$ ，由于滑移面很

多，因而常由交滑移而使滑移线呈波纹形。

体心立方易发生交滑移说明它的层错能很高，因而不易出现折断位错。滑移方式，当 $\Sigma |b_i|^2$ 时，滑移面为 $\{0001\}$ ，反之为 $\{10\bar{1}0\}$ 或 $\{\bar{1}0\bar{1}1\}$

对层错能小的晶体，可看到 $\Sigma |b_i|^2 \rightarrow \frac{1}{3} [11\bar{2}0] \rightarrow \frac{1}{3} [10\bar{1}0] + \frac{1}{3} [\bar{0}1\bar{1}0]$

后者表示为剪切力个全位错的作用，这时只有一片层错，构成对推位错。

32. NaCl 晶体的滑移系是 $\langle 110 \rangle < 110 \rangle$, 对于最像非晶 $\langle 100 \rangle$, 为了

正. 位错对跨过滑移面, 阻碍作用很强, 一般不能滑移。

NaCl 晶体中单位位错的伯氏矢量 $b = \frac{a}{2} \langle 110 \rangle$. (联结相邻同
类离子的最短距离).

33. (外表面: 自由表面 (与其相对分界面))

界面上 { 外表面: (晶粒边界)
内表面: (晶内的亚晶界、型晶界、位错及相界面)

由于成分偏聚和表面对称的作用, 往往导致表面对称与体内不一。

表面能与晶内表面的排列取向程度有关, 除了密排面的表面具有最小的表面能。若以简单密堆积作表面对时, 晶体的能量最低、最稳定, 所以自由晶体暴露在外的表面通常是低表面能和简单密堆积。

晶体的表面能还与晶体表面曲率有关。其他条件相同时, 曲率越大, 表面能也越大。

这是某种界面

34. 属于同一固相但位向不同的晶粒之间的界面称为晶界,
而每个晶粒有时又由若干个位向稍有差异的亚晶粒所组成, 相邻亚晶粒间的界面称为亚晶界。

一般在晶界中的晶界具有三个自由度。

位错间距为 $D = \frac{b}{\delta}$

位错密度: 可看成单位体积内位错构成:

晶界 { 小角度晶界 { 扭转晶界: 可看成球状的螺旋形错排或, 自由度 | 重合晶界 }

大角度晶界 { 大角度晶界模型: 重合位错点阵.

35. 晶界能变化形成单纯晶界和界面时, 系统的自由能变化 (图).

(1) 小角度晶界的能量主要来自位错的能量, 而位错密度又决定于晶粒间的位向差, 所以小角度晶界能也和位向差有关。

$$\gamma = \gamma_0 \theta (A - 1/n\theta)$$

γ_0 为常数, A 为积分常数, 决定位错中心/原位错排列性。

小角度晶界能随位向差增加而增大。(只适用于小角度晶界)

(2) 大角度晶界一般为大角度晶界, 与晶粒位向无关, 大体上为定值。

36. 当晶粒将两个晶粒 (或一个晶粒的两部分) 沿一个公共晶面构成“镜面”对称的位向关系, 这两个晶粒就称为“孪晶”, 此公共晶面就称孪晶面。

孪晶界 { 共格孪晶界: 界面能很低 (每单位面积 γ_0), 很稳定, 且可成较平缓, 这种类型的晶界能量相对较高 ($\gamma_0 \sim \gamma_2$)
一般层错能高的晶体不易产生孪晶。

37. 具有不同结构的两相之间的分界面称为“相界”。

其格相界
半共格相界: 相界面上会出现一些空缺。
非共格相界: 与大角度晶界相似

$$\text{半格相界} \quad \text{错配度} \quad \delta = \frac{a_\alpha - a_\beta}{a_\alpha}$$

(1) 位错间距 $D = \frac{a_\beta}{\delta} = \frac{a_\alpha \alpha_\beta}{\alpha_\alpha - \alpha_\beta}$.

δ 很小, D 很大 \rightarrow 半格相界
 δ 很大, D 很小 \rightarrow 非共格相界。

相图

2. 相界能包括：弹性畴变和化学位作用能。

弹性畴变能大小取决于磁感应强度，而化学位作用能取决于界面与周围原子的化学键结合状况。

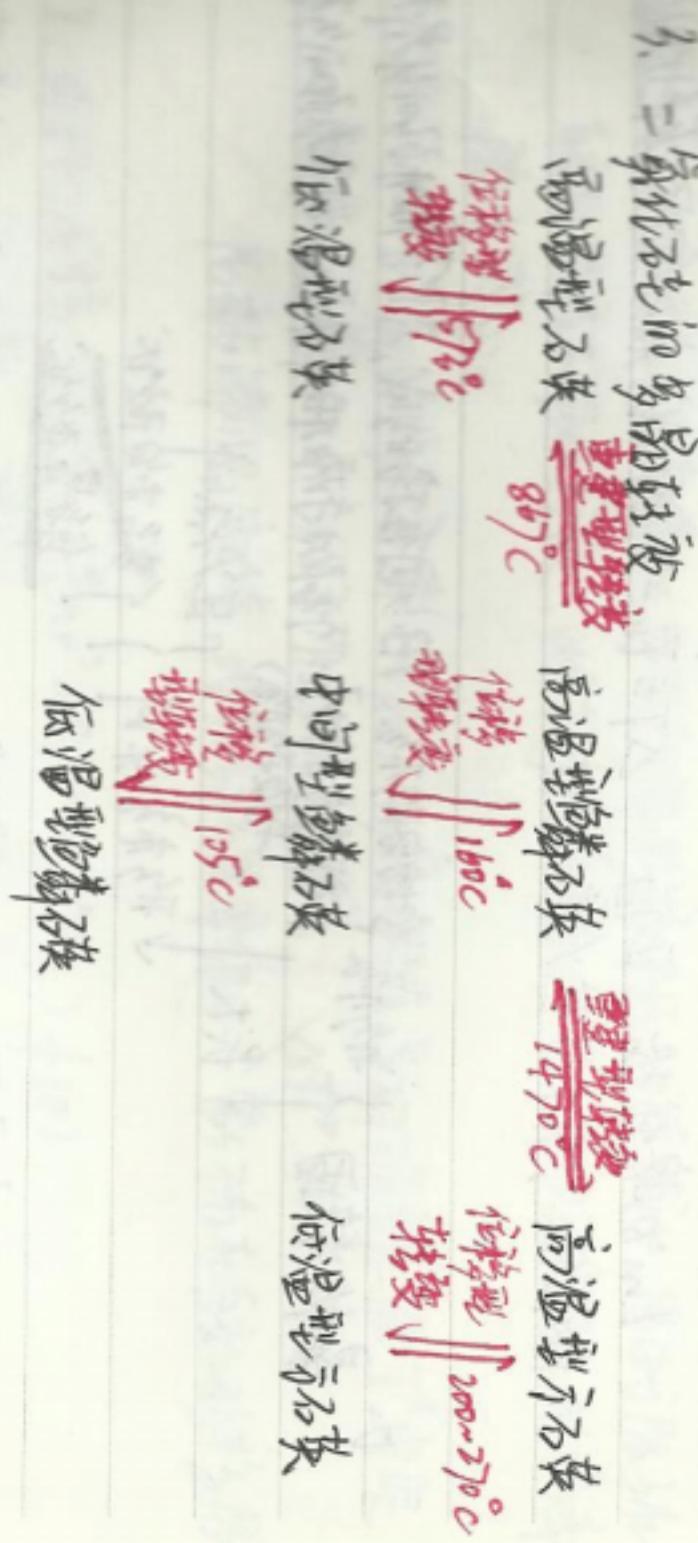
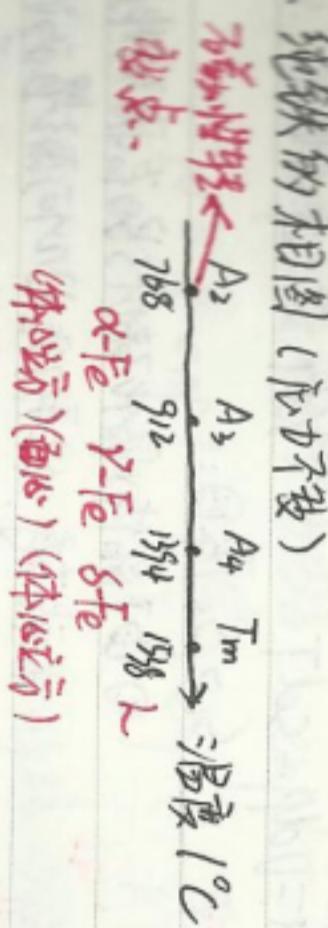
对共格相界，应变能是主要的；对于非共格相界，其界面能以化学位能为主。

相界能比较：非共格相界 > 半共格相界 > 共格相界。

弹性畴变能：取决于磁感应强度。

化学位作用能：取决于界面上原子与周围原子的化学键结合状况

d. 计算相图分界线斜率的近似（或无序）可用克劳修程

$$\frac{df}{dt} = \frac{\Delta H}{T\Delta V_m}$$


4. 液态结构

特征：原生排长形畴，短程有序，结构起伏

原生平均距离：液体 < 固体

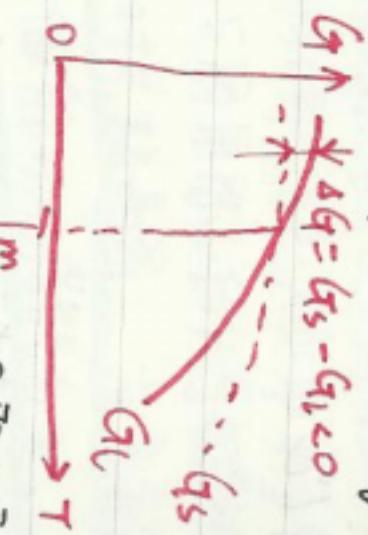
此消很长，距离很短，对不稳定的结构

原生配位数：液体 (8~11) < 原生晶体

特殊例子：非原生排结构晶体 (Sb, Bi, Ga, Ge 等)

液态配位数增大，形成化体质，略为收缩

$$5. G = H - TS \quad dG = Vdp - SdT \quad \frac{dG}{dT} = -S < 0$$



① 由于晶体熔化破坏了晶态原子排列的长程有序，使原子之间几何配置的混乱程度增加，因而增加了熵。

② 除了振动幅度增大，振动熵也略有增加。

$$\Delta G_v = G_S - G_L = (H_S - H_L) - T(S_S - S_L) = -L_m - T\Delta S_m$$

$$\Delta S_m = -\frac{L_m}{T_m} \quad ; \quad \Delta G_v = -\frac{L_m \Delta T}{T_m}$$

L_m 为熔化热，正值。 $\Delta T = T_m - T$ 即熔点与实际凝固温度的差值，称为过冷度。

b.

晶体凝固 { 形核 } 均匀形核：界面直接形成，不需杂质或外来界面
{ 非均匀形核 } 非均匀形核：依赖于液相中杂质或外来界面
长大 ↓ 形核条件 { 及冷凝 } 结构相变

均匀形核驱动：自由能降低 ($\Delta G_v < 0$)：液态聚集成→晶态排列
阻力：表面自由能增加：晶胚构建成新的界面

$$\Delta G = \frac{4}{3} \pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma$$

$$1/ \text{临界半径} r^* = -\frac{2\sigma}{\Delta G_v} = \frac{2\sigma}{L_m \Delta T}$$

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\sigma^3}{3(4\pi r^*)^2} = \frac{16\pi\sigma^3 T_m^2}{3(L_m \Delta T)^2}$$

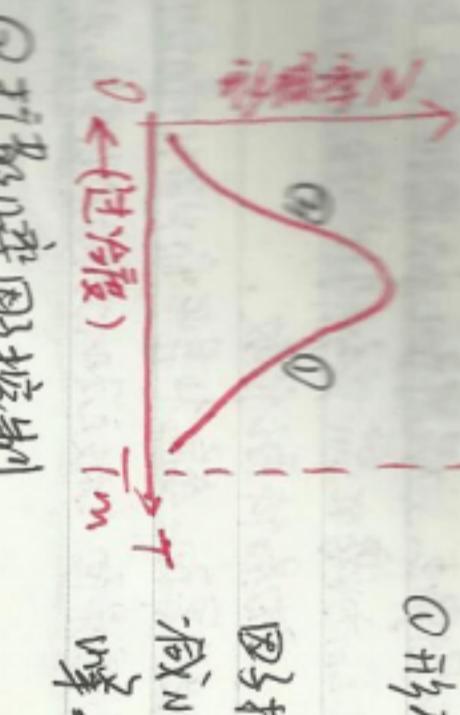
$$1/\text{临界晶核表面积} A^* = 4\pi(r^*)^2 = \frac{16\pi\sigma^2}{\Delta G_v^2} \Rightarrow \Delta G^* = \frac{1}{3} A^* \sigma$$

$$7. 形核率: \frac{dN}{dt} = N \exp(-\frac{\Delta G^*}{kT}) \exp(-\frac{\Delta G^*}{kT}) \cdot \exp(-\frac{Q}{kT})$$

$$N = k \exp(-\frac{\Delta G^*}{kT}) \cdot \exp(-\frac{Q}{kT}) \quad Q: \text{界面的扩散及深能}$$

① 形核功因抑制

过冷度较大时，形核率随形核功减小；形核速率迅速增加，并达到最高



② 打散抑制

过冷度继续增加，虽然所需形核半径继续减小，但由于原生核被原生核下堆积打散，此时形核率慢打散反而抑制，形核率随之减小。

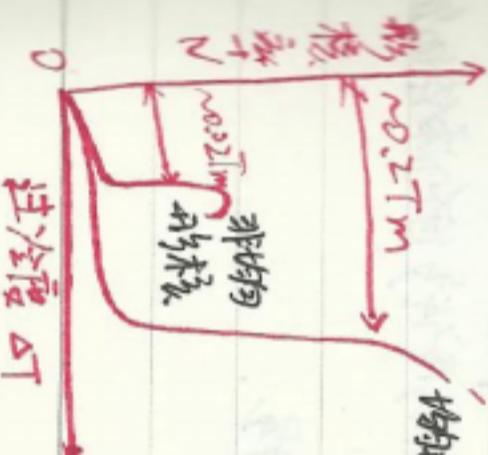
对易流动液体(金属)形核率随温度下降到某值 T^* 时突然显著增大， T^* 称为有效形核温度。 $\Delta T^* \approx 0.2 T_m$ 。
高黏滯性液体，均匀形核速率很小，常分布在有效形核区。

$$8. 非均匀形核 \quad \Delta G = (\frac{4}{3} \pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma) + f(t)$$

$$r^* = -\frac{2\sigma}{\Delta G_v} \quad \Delta G_{het}^* = \Delta G_{hom}^* f(t)$$

$$f(t) = \frac{2-3\cos\theta+2\cos^2\theta}{4} \quad 0 < 180^\circ \text{ 时, } \Delta G_{het}^* < \Delta G_{hom}^*$$

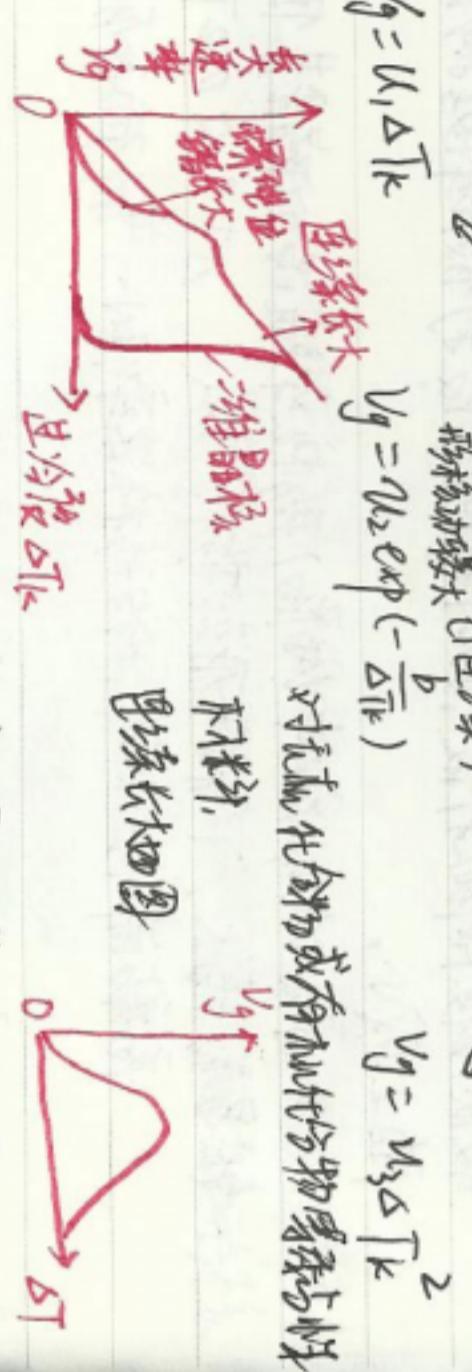
非均匀形核需要合适的“基底”，随着新相晶核的增多而减少，在“基底”减少到一定程度时，将使形核率降低。



最低能级

9. 在某些情况下，固液界面处于局部平衡，界面结构是界面能 \bar{N} 个原子随机械沉降时，具有 N_1 个原子位置的固液界面时，自由能的相对变化 $\frac{\Delta G_{\text{rel}}}{N_1 k T_m} = \alpha x(1-x) + \gamma \ln x + (1-x) \ln(1-x)$
- k 为玻尔兹曼常数， T_m 是熔点，界面以被固相原子占据的值置为 $\alpha = \frac{3L_m}{kT_m}$ ，其中 L_m 为熔化热， $\gamma = \eta/\rho$ 总小于 1。其中， η 为界面原子的平均配位数， ρ 为晶体配位数。
- $\alpha \leq 2$ 时，液-固界面为粗糙界面，金属和某些低熔化熵的有机化合物 $\alpha > 2$ 时，液-固界面为光滑界面：多羟基化合物及重金属和半导体。

10. 固体长大方式：连续长大、二维晶核、螺旋沉淀长大。



11. “正温度梯度下，结晶潜热只能通过固相而散出，相界面的堆移速度受固相传热速度所控制。晶体生长以接近平面状向前推移若光滑界面结构扁平，生长形态呈阶段（光滑界面）若粗糙界面结构扁平，生长形态呈平面状（粗糙平面）。
- 当负温度梯度下，液-固界面不可能保持平面状而会形成许多微小液滴的分布
- 称为树枝状结晶。
- 树枝生长在粗糙界面（金属）表现最为明显。 α 值大的物质，仍保持小平面特征。

12. 用金属铸件晶粒为细小，可采用的途径。

- (1) 增加过冷度
 a. 形成核剂的作用
 b. 振动促进
 c. 振动促进形核法
- 制备方法 a. 直接退火法
 b. 小端形核法
- 半成品金属的制备方法：离心急冷法和轧制急冷法

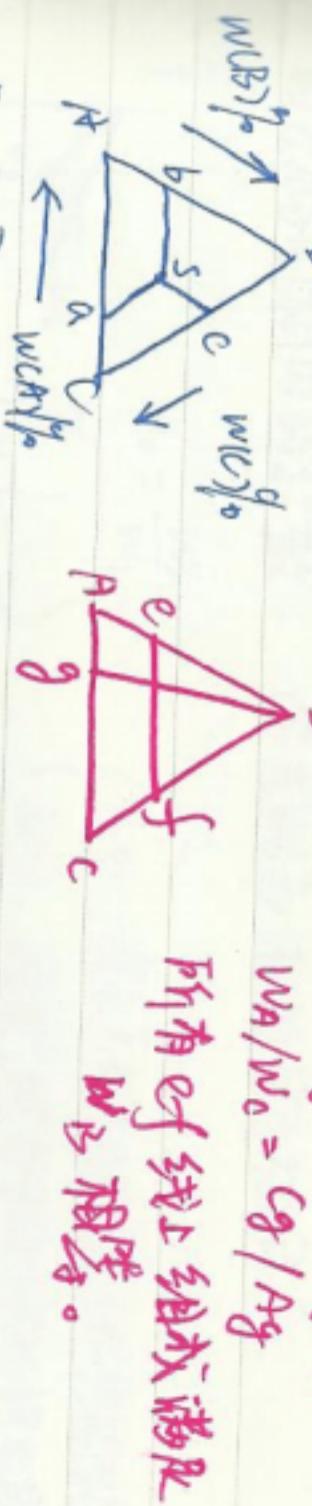
增加过冷度

形状记忆合金
相变促进形核

三元相图

- 四相共存区 → 恒温水平曲。
- 二相平衡区 → 占有一定的空间。

2. 三元成分三角形表示方法。



3. 三元相图的垂直截面中不能应用直线法则来确定两相的重量分数，也不能用杠杆定律计算两相的相对量。

三元相图

直线法则: 在一定温度下三组元材料两相平衡时，材料的成分点和其两个平衡相的浓度点必然位于成分三角形内的一条直线上。

杠杆定律

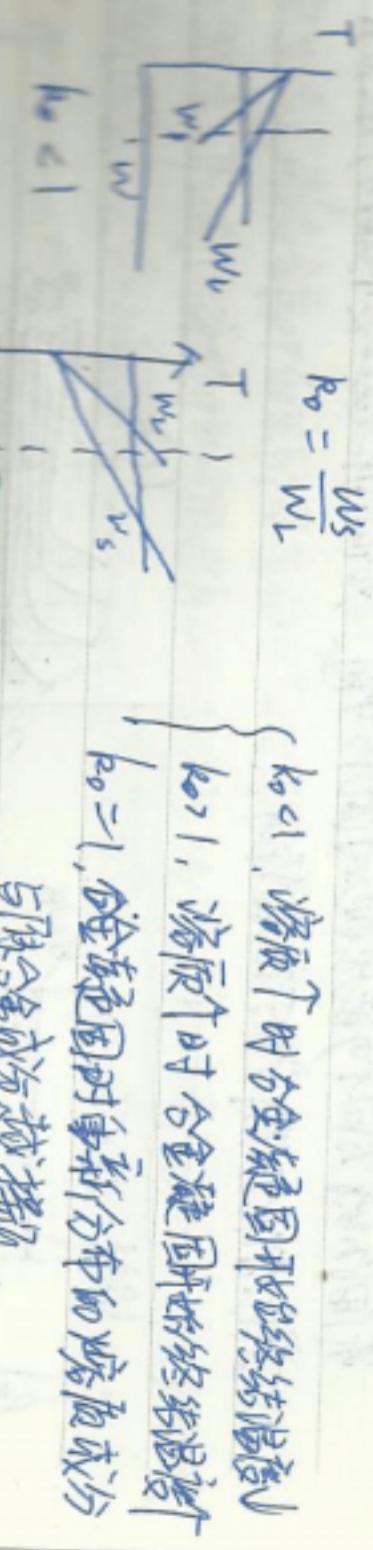
重心定律: 质量重心。

5. 三元相图每相邻相区的相数差 1 (点接触除外)。

除截面截到四相平衡面上的相成分支外，相图中每行相界线交点上必有一条相界线相交，这也是判断界面是否正确的法则之一。

16) 液体非平衡凝固时，假设条件：

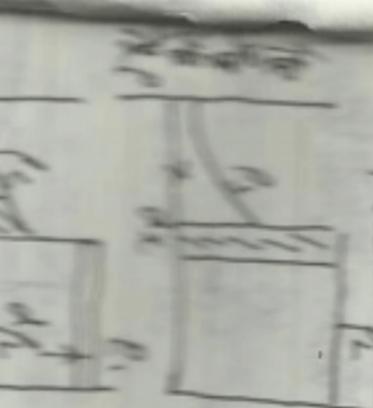
- ① 液相成分任何时候都是均匀的；
- ② 液-固界面是平直的；
- ③ 液-固界面处维持着这种局部平衡，即在界面处满足 k_0 为常数；
- ④ 固相各相内的扩散； ⑤ 固相和液相密度相同。



重新分布的幅度越小)

① 假设图

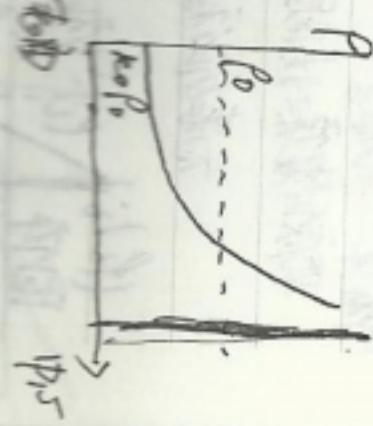
$$dM = \rho_A dx.$$



$$\rho_B = \rho_0 (1 - \frac{x}{L})^{k_0-1}$$

$$\rho_L = \rho_0 k_0 (1 - \frac{x}{L})^{k_0-1}$$

$$dM = \rho_A dx + d\rho_L (1 - x - dx)$$



2° 试求浓度

$$dM = m(x+dx) - m(x)$$

$$\frac{d(\rho)}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{s(x)}{\rho_0}$$

$$= (\rho_0 L - \rho_0 dx + \rho_0 dx) - \rho_0 L$$

$$= \rho_0 dx - s dx$$

$$\beta = \rho_0 [1 - (1-k_0) e^{-\frac{k_0 x}{v}}]$$

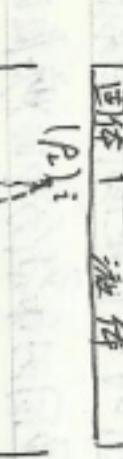
$$-\frac{k_0 x}{v}$$

$$\rho_s = \rho_0 [1 - (1-k_0) e^{-\frac{k_0 x}{v}}]$$

P_s : 液体能穿透边界层时液体均匀分布?

P_{rs} : 流体可通过扩散而对流两种途径, 尤其是对流更容易渗透在液体壁附近, 得均匀分布。 \rightarrow 流态完全具有低粘度和高密度存在自然对流。

界面沿线方向可能出现对流传播, 液体质点能通过缓慢扩散形成穿过边界层才能输出。



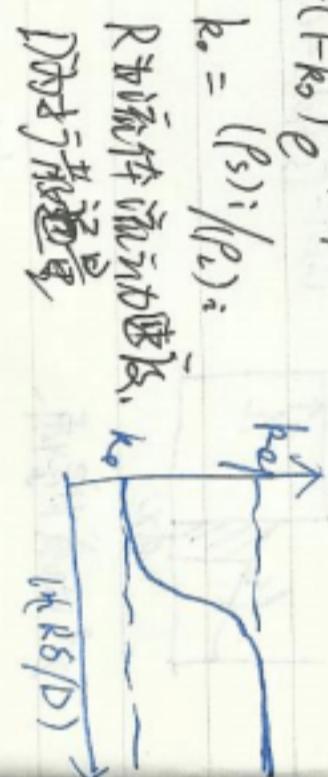
扩散律 元解集
液体的聚集对湍流固相将造成影响。
为表征固体中混合程度, 定义有效扩散系数 $k_o = \frac{(\rho_3)_i}{(\rho_2)_B}$

$$k_e = \frac{k_o}{k_o + (1 - k_o) e^{-RS/D}}$$

(ρ_2)_i 固体
(ρ_2)_B 流体

其中

$$k_o = (\rho_3)_i / (\rho_2)_i$$



扩散律
D 表示扩散量

图例: \square 流体 \square 固体

$k_e = 1$, 流体扩散快 $R \rightarrow \infty$, 流体质点不混合。

$k_e < 1$, 流体质点被扩散, 边界层厚度最大为 $12.7cm$

$k_e = k_o$, 流体质点扩散 $R > 0$, 金属混匀。

流体质点对流使边界层不均匀, 增质完全混匀。

$k_o < k_e < 1$, 介于两者之间, 不纯混流。 (边界层外流体质点扩散速率同对流质点情况)

结论: 1. 当希望获得最大扩散系数时, 则取 k_e 尽可能接近 k_o , 即 RS/D 可能小。

即要求一个从边界面到边长 R 和高程度的混合, 以减小 δ 。

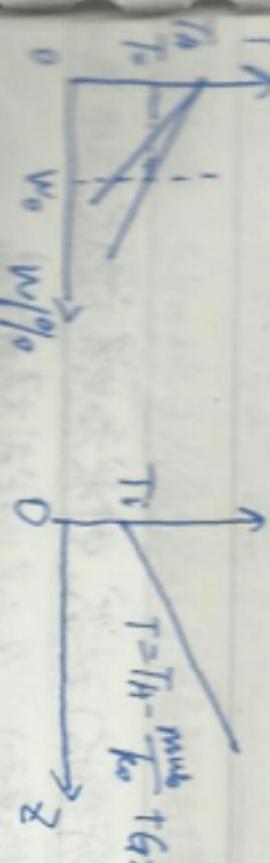
2. 希望得到均匀的温度分布式样, 要求 $k_e = 1$ 。要求高的界面速度和无混合以达到最大 δ 值。(因扩散系数对边界层最后流动层影响大)

热性质: 金属冷却而其外温度低于 T_m 时, 为辐射冷却, 表达为 α 。

△热性质: 热流沿液体中的实际温度低于由液体分布所决定的凝固温度时产生的热。

两个因素: ①液-固界面沿液体中的温度质量浓度分布 ② 邻界温度分布。

$$T_b = T_h - \frac{m_w}{k_o} + G_2$$



$$W_i = W_o (1 + \frac{k_o}{k_o C} - \frac{R^2}{D})$$

冷却成分为 W_i 。
液体实际温度分布

$$\frac{T_c - T_A}{T_0 - T_A} = 1 + \frac{k_o}{k_o C} - \frac{R^2}{D}$$

$T_c = T_A + m_w (1 + \frac{k_o}{k_o C} - \frac{R^2}{D})$

冷却成分为 W_i 。
温度分布所决定的凝固温度。

$$\text{当 } k_o \text{ 很大时 } (k_o = 1) \text{ 时}$$

冰相固相接触时 $T_c = T_A$ 。

$$G < \frac{dT}{dz} \Big|_{z=0}$$

$$\Rightarrow \frac{G}{R} < \frac{m_w}{D} \frac{1 - k_o}{k_o}$$

ΔT : 合金凝固温度
范围。

1) 组分: 1) m_0, m_1, k_0, n , 使得 ΔT 范围增大, 有利于成分过冷。

2) 扩散系数 D 越小, 边界层中溶质越易聚集, 有利于成分过冷。

3) 实际温度梯度越小, 对应的合金和液相固溶度, 成分也会增加。

4) $k_e = k_0$ 时, 液-气完全混合, 液-气界面前沿没有溶质聚集, 不会出现成分过冷。

5) 由于成分过冷, 会使合金在过冷温度梯度下凝固得到树枝状组织(胞状组织), 而在纯金属凝固中, 则会得到同样组织必须在获得的特殊温度梯度下。成分过冷是合金凝固时形成枝晶的重要特征。

共晶组织可分为片状、棒状(纤维状)、球状、针状和螺旋状。

1. 金属-金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

2. 非金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

3. 金属-非金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

4. 非晶-非晶型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

5. 非晶-金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

6. 非晶-非金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

7. 非晶-金属-非金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

8. 非晶-金属-金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

9. 非晶-非晶-金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

10. 非晶-非晶-非晶型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

11. 非晶-金属-非晶型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

12. 非晶-非晶-金属型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

13. 非晶-非晶-非晶型共晶(粗粒-粗粒界面): 多为层片状或棒状共晶。

2. 金属-非金属型共晶。(针状、骨骼状)

金属型粗粒界面前沿液相的动态过冷度约为 0.02°C , 非金属型光滑界面前沿液相的动态过冷度约为 $1~2^\circ\text{C}$ 。但 Al-Si 共晶界面过冷度主要来源于成分过冷, 而不是动态过冷, 生长方式是由两相的质晶分散并和成分过冷所决定的。在金属-非金属型共晶中适当加入第三组元, 共晶组织可能发生很大变化。

e.g. Al-Si 合金加入少量钠盐可使 $\beta(\text{Si})$ 相细化, 分枝增多;

铸铁中加入少量镁和稀土元素, 使片状石墨细化, 称为“变质处理”。

共晶组织为何界面是柱状的?

共晶生长中, 由于扩散过冷度很小, 和激烈地横向扩散, 使液-气界面前沿的动能不足以克服成分过冷。

层片生长的动力学

单位体积共晶液体的凝固熵。

共晶合金凝固时, 释放出来的单位体积自由能 $\Delta G_B = \Delta S_B \Delta T_E$ 。

$\Delta G_B = \Delta G_d + \frac{2\Delta f}{s}$, s : 层片间距, ΔG_d 扩散需要的自由能。

$$\text{Df} S_{min} = \frac{2\Delta f}{\Delta G_B} \quad \Delta G_d = \Delta S_f \Delta T_E \left(1 - \frac{S_{min}}{s} \right)$$

$$\Delta G_B + \Delta G_d + \Delta G_s \Rightarrow \Delta S_f \Delta T_E = \Delta S_f \Delta T_d + \Delta S_f \Delta T_s.$$

$$\text{扩散成分量 } \Delta w = \Delta T_d \left(\frac{1}{m_d} + \frac{1}{m_p} \right)$$

界面移动速度方程

$$R = \left(\frac{1}{m_d} + \frac{1}{m_p} \right) \frac{4\gamma_{dp} D}{\Delta S_f (m_d m_p)} \cdot \frac{s^2}{\Delta w}$$

层片间距 S_{opt} 随 R 单调地减少。

常 R 的规则共晶层片间距约为 $1~3 \mu\text{m}$ 。

晶界面的稳定性

1. 纯二元共晶:

古兹在正的温度梯度下, 平直界面是稳定的, 一般不会出现树枝晶。

① 对于金属-非金属型共晶, 可能由于非金属生长的动态, 相速度较大, 会形成

较大的溶质聚集 在较低的温度梯度下, 产生树枝晶, 并形成树枝晶。

2. 含杂质的二元共晶: 如果杂质质量较少, 成分速度不大, 层片偏析向垂直于界面生长。

如果杂质质量足够多, 就可能形成树枝晶。

3. 二元共晶: 伪共晶的成分在 α 和 β 之间, 仅取决于伪共晶中 α 和 β 相对量,

当合金凝固时有规则的共晶组织, 必须满足两个条件:

① α -固界面附近的液相成分接近共晶成分 α_{eq} 。 \rightarrow 可由界面上溶质聚集

$GCR = m_P / (m_e - m_P) / D$ 成分也到此而液相可进行共晶反应, 获得共晶组织。

② 伪共晶区指出在很小的温度梯度和相当高的冷却速度下, 可以获得伪共晶组织的成分范围。

铸锭件的宏观组织

由表及里: 表层细胞区、柱状晶区、中心等轴区。

快的冷却速度、高的浇注温度和定向凝固有利于柱状晶的形成。(金属)

慢的冷却速度、低的浇注温度、加入有效形核剂或搅拌有利形成中心等轴晶。

③ 树枝晶: 优点是组织致密, “铸造组织”也可被利用。

e.g. 立方金属 (α) 方向与模腔长轴平行 \rightarrow 破碎的铁合金。

“铸造组织”: 液相结晶方向相同, 这种晶体学方向一致的铸造组织。

缺点: 相对于柱状晶而言其相速度的扩散区交界面较为脆。

结论: 将杂质易熔杂质和非金属杂质, 特别热加工时易沿这些弱界面, 铸件使用时也易在这些地方断开。

偏析

1. 重偏析

重偏析的液-固界面附近的液相中溶质在结晶时冷, 界面大多为树枝

状, 适合改变偏析的形式。当树枝状偏析的液相伸时, 溶质将沿纵

向冷却(即外), 从顶部的溶液偏析到枝晶轴方向的宏观偏析, 而

枝晶的底部偏析会引起垂直于枝晶轴方向的微观偏析。

1. 正常偏析 (区域偏析): 均匀偏析、层状偏析和中心偏析。

① 正常偏析: ($k_c < 1$ 时), 先凝固的层中溶质含量较高, 距离内层为低。

② 反偏析: $k_c < 1$ 的合金铸件中, 溶质含量在铸件中分布属于第二相。

只在当合金凝固时伴生偏析, 并且母体中含有除才溶解成反偏析。

柱状晶+合金凝固温度时间较长, 和其中溶有气体时, 有利

抑制途径: 扩大铸件的冷却速度, 由此柱状晶的发展, 使富集杂质的液

体不易从柱状晶分离, 使液相中的气体含量。

③ 地重偏析: 在向上浇, 重力作用, 导致上下成分不均。

防止方法: 增大铸件冷却速度, 或加入第三种合金元素。

2. 显微偏析: 细胞偏析、枝晶偏析和晶界偏析。

① 细胞偏析: 成核过冷度较小, 因溶体质点细小, “细胞”偏析。

$k_c < 1$, 且铸造温度较低, $k_c >$ 细胞处溶体质点细小, “细胞”偏析。

因为细胞体积较小, 很容易被均匀化退火消除。

② 枝晶偏析: 温度过大, 偏析元素在固溶体中的扩散能力越小,

而且固溶度范围越宽, 晶内偏析越严重。

③ 晶界偏析: 由于该杂质浓度 $k_c < 1$ 在最后凝固的晶界部分而造成。

影响因素：

溶质含量越高，程度越大；
浓度增加；结晶速度慢使溶质分子有足够的时问扩散并富集
在液-固界面附近而沉淀相中，增加晶界偏析程度。
枝